



東証スタンダード：3131

2024年3月期（2023年度）決算説明資料

2024年5月10日

1. ポイント・お伝えしたいこと

| 項目・年度 | | ポイント |
|-----------------|---------|---|
| 売上高 | 2023年度 | システム製品分野は増収となり、足元でメモリ及びディスプレイ市況の底打ちにともない汎用品のボリュームビジネスの悪化に歯止めがかかったため、0.9%の増収。 |
| | 2024年度 | 半導体製品が年度後半より本格回復を想定していることと、ディスプレイ分野も新規ビジネスの立ち上がりを想定しており、汎用品ボリュームビジネスが徐々に回復に転換すると見込み、2.6%増収の見通し。 |
| 営業利益 | 2023年度 | 汎用品のボリュームビジネスの減収に伴う売上総利益の減少と、ディスプレイ分野における主要取引先の民事再生に伴う当該売掛債権を貸倒損失として計上した結果、販売費及び一般管理費が大幅に増加したため、47.2%の減益。 |
| | 2024年度 | 比較的に高採算分野であるシステム製品分野等の増収効果による売上総利益の増加と、販売費及び一般管理費は、2023年度の貸倒れに関連した費用の発生がないと想定し、43.5%の増益見通し。 |
| 経常利益 | 2023年度 | 営業利益の減少に加え、営業外損益において、期末の円安進行によって為替差損が増加したことと、ドル金利の高止まりによる支払利息の増加によって、61.7%の減益。 |
| | 2024年度 | 営業利益の増加と、想定レート（＝固定レート）の適用による為替変動がないものとして想定した場合、2023年度計上の為替差損が発生しないこととなって増加要素となるため、150.4%の増益見通し。 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2023年度 | 特別損失（投資有価証券評価損）を50百万円計上し、67.4%の減益。 |
| | 2024年度 | 2023年度発生の特別損失及び特別利益の発生は見込まないため、190.5%の増益見通し。 |
| 配当 | 2024/6月 | 配当単価60円、配当性向40.5%。株主様への還元と、今後の財政状態等を総合的に勘案し2023年8月8日公表の配当予想単価を維持する予定。 |
| | 2025/6月 | 配当単価125円、配当性向29.2%。 2024年5月10日公表の業績見通しに基づき設定。 |

お伝えしたいこと

- ① 中期経営目標（2025年度 経常利益15億円）に変更はない。 その根拠は、以下のとおり。
2023年度のメモリやディスプレイの後退市況（リセッション）の中においても、一時的な貸倒関連費用の発生（ノイズ）を除いて試算した場合、2021年度に迫る経常利益水準とみなせ、地力がついてきています（4ページグラフ参照）。
- ② 2024年6月実施の配当については、株主様への還元と今後の財政状態等を総合的に勘案し、株主総会に上程する予定です。
2025年3月期の配当予想は、業績予想に基づき配当性向「30%を目安」として設定。

2. 中期経営目標（2026年3月期）

次期中期経営期間における販売戦略は、推進中の「収益構造改革」の基本構造を踏襲しつつ、経営基盤戦略を充実させ、下記の中期経営目標の達成に向けて邁進します。

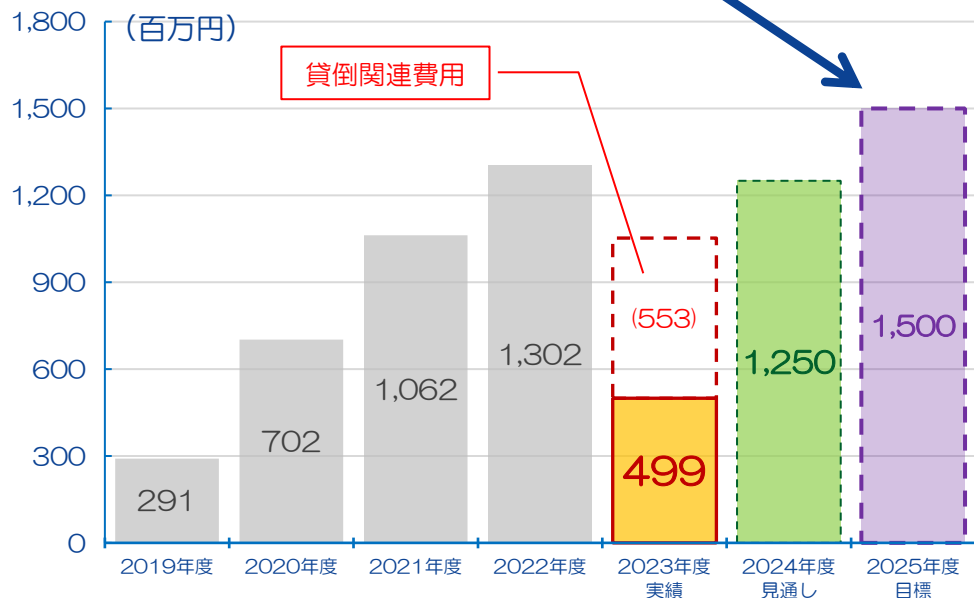
目標①

変更なし

2025年度連結経常利益

15億円

【経常利益】



目標②

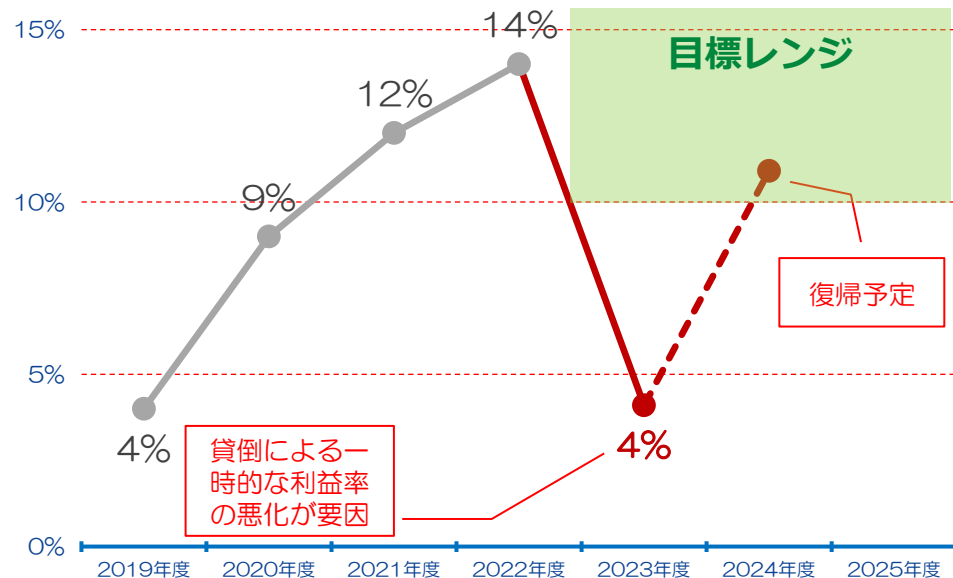
変更なし

ROE

(※) 自己資本利益率
ROE=当期純利益÷自己資本×100

10%以上を継続する。

【ROEの推移】



3. 中期経営方針

中期経営方針 **重要な変更なし**

全社一丸となり、デジタル・トランスフォーメーション（DX）、グリーン・トランスフォーメーション（GX）市場の開拓を推進し、サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）への寄与をもって社会への貢献し、企業価値の向上を目指す。

全社

方針基盤

「収益構造改革」の基本構造を踏襲

- ① 高利益率化を追求する。
- ② 単品販売志向から脱却し、システムソリューション販売を強化する。
- ③ 経営基盤を強化並びに資金効率の向上をもって財務体質を強化する。

2023年度の
経験を糧に！



与信管理の更なる強化

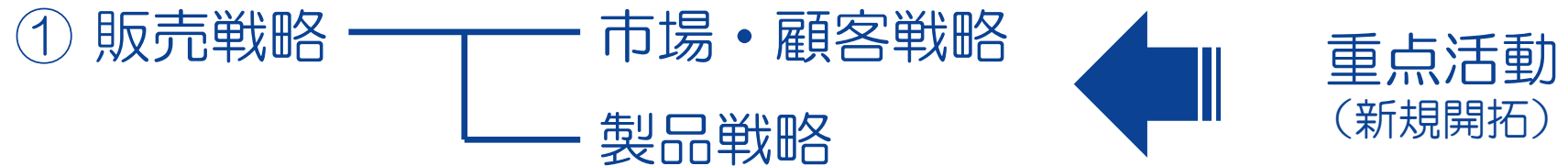
DX市場
GX市場
▼
開拓を推進

SXへの寄与
▼
社会への貢献

企業価値
の向上

4. 中期経営戦略等

変更なし



③ サステナビリティに関する考え方

※上記の戦略等にかかる詳細は、後述のAPPENDIXをご参照ください。

5. 2023年度の取組みと展望

メモリ・ディスプレイ市況の逆風、主要取引先の民事再生

取組み

■業務提携を積極的に実行



収益の源泉の多様化を図る。

■システム製品分野の拡大

- ・EMS/検査等装置ビジネスの拡大
- ・AIサーバー機器の新規取扱い

■足元でメモリ市況が底打ち

- ・循環市況の好転への期待

展望

高利益化による筋肉質な体質への改善の取組みを継続する。

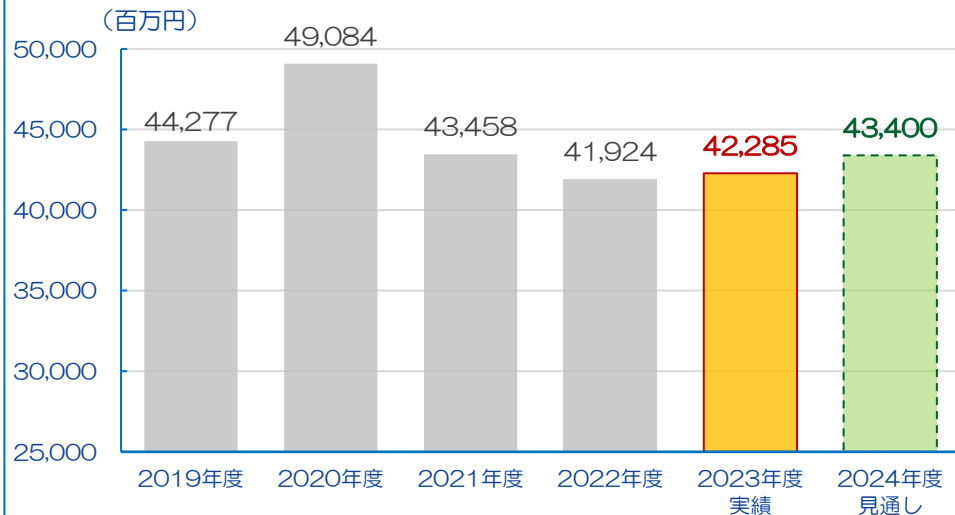
資本効率の向上

DXの進展に伴う
AIの民生化に期待

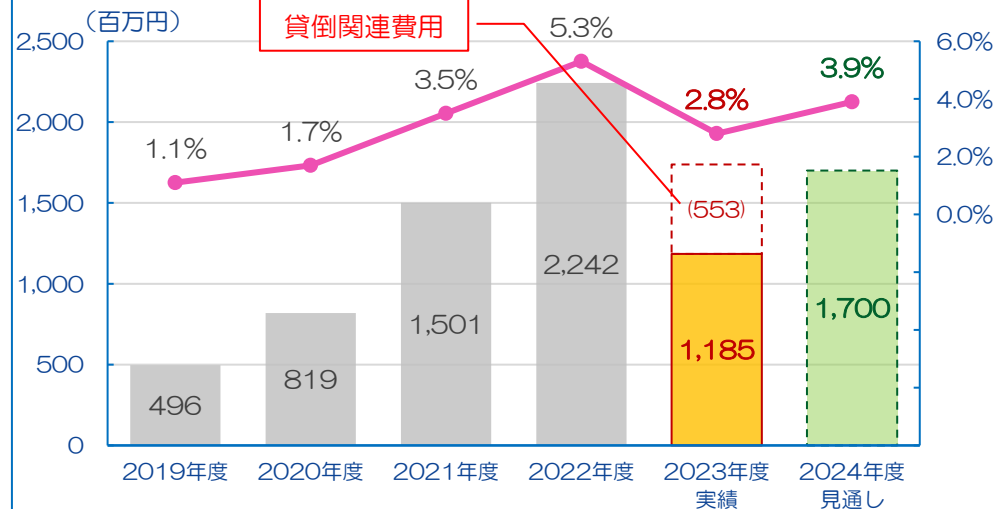
需給バランスによって短期的な増減を繰り返しつつ、中長期的には需要は伸びると見込む。

6. 実績と見通しの推移

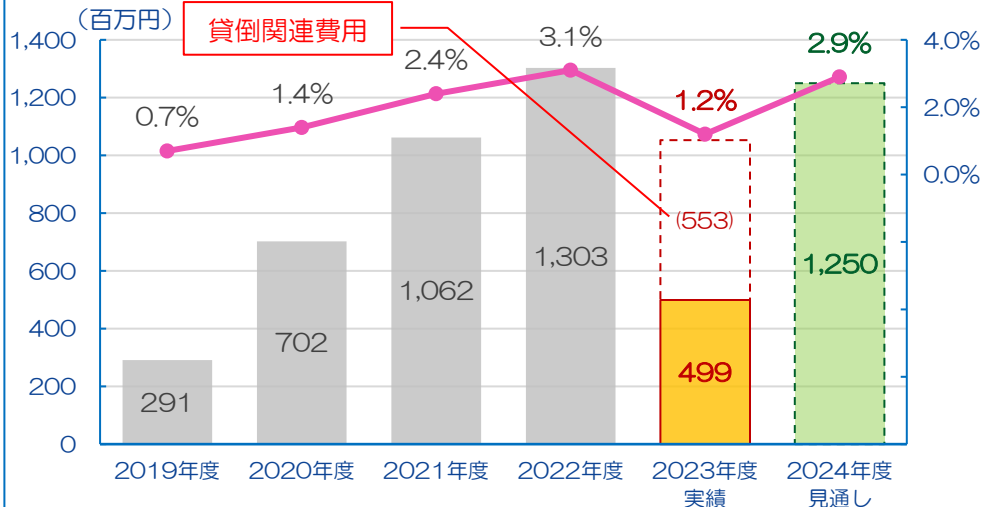
売上高



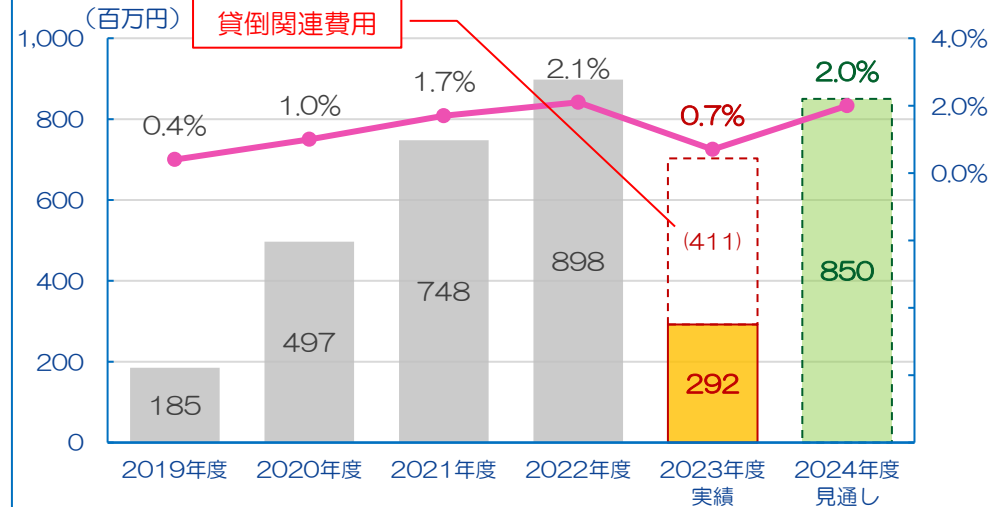
営業利益 (右軸利益率)



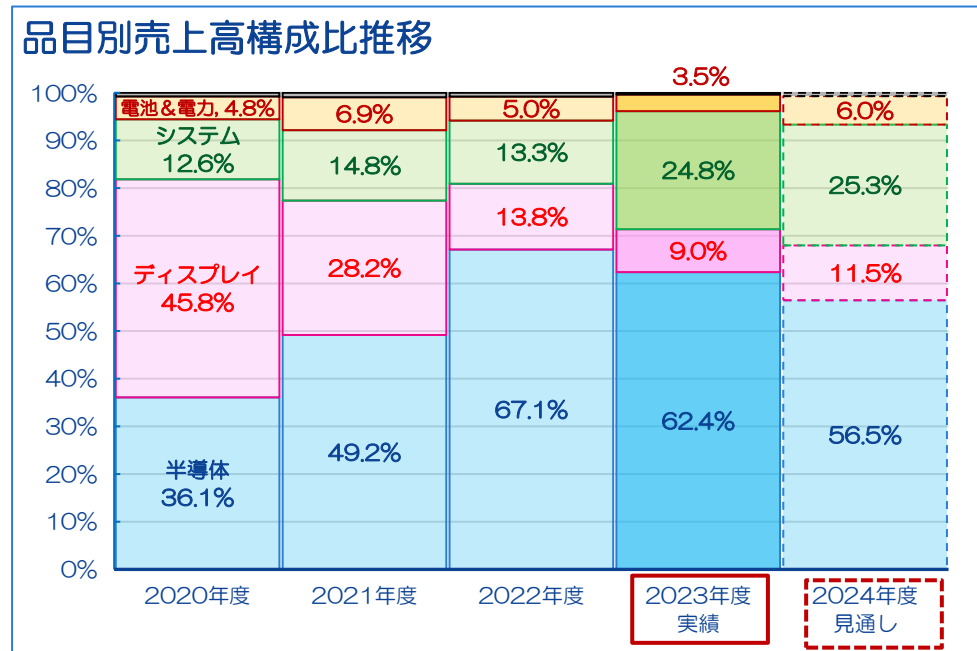
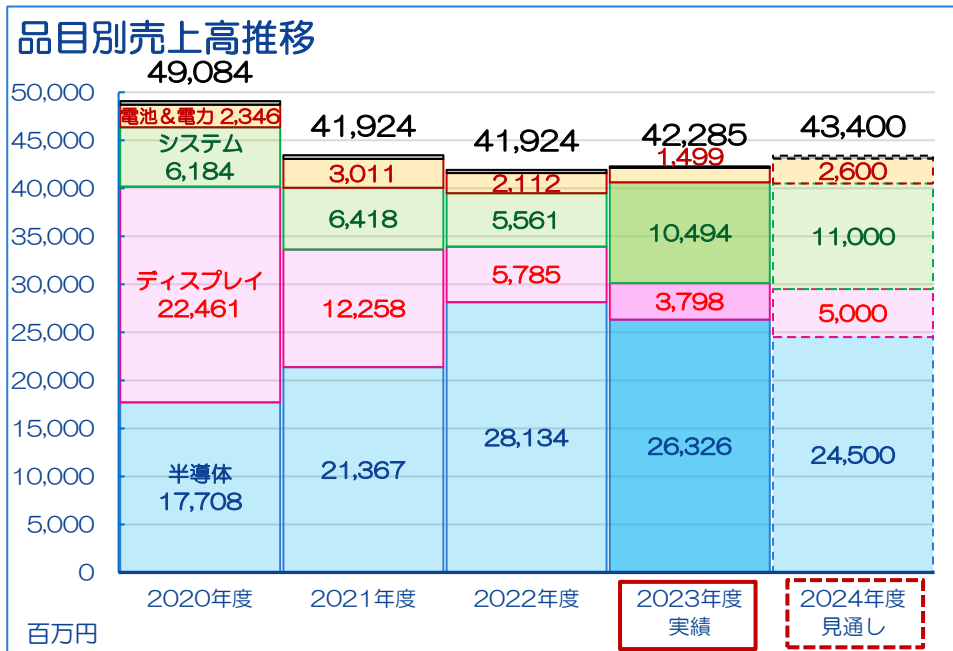
経常利益 (右軸利益率)



親会社株主に帰属する当期純利益 (右軸利益率)



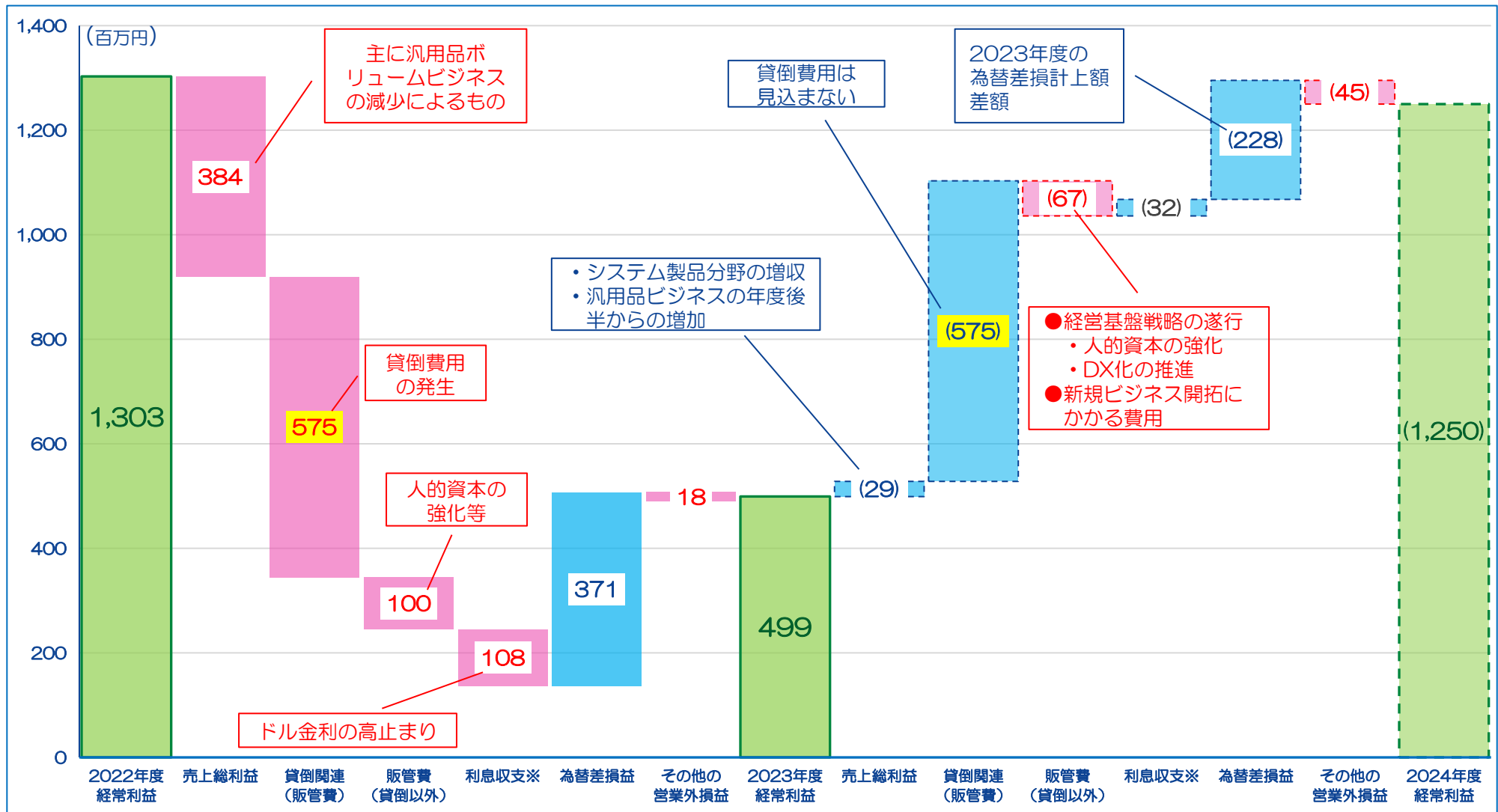
7. 品目別売上高・構成比の推移



| 品目別 | 増減要因 |
|------------|---|
| 売上高総論 | 2023年度は、半導体・ディスプレイの汎用品ビジネスの不調により減少。 2024年度は、システム製品分野が堅調に推移することと、半導体・ディスプレイ市況の回復を想定し、増加見込み。 |
| 半導体製品 | 2023年度は、メモリ市況の悪化の影響により減少。 2024年度は、メモリ市況は足元で底打ち感があるが、本格的な回復が年度中盤以降と想定し、減少見込み。 |
| ディスプレイ | 2023年度は、市況の悪化と主要顧客の民事再生により減少。 2024年度は、液晶モジュールの増加、年度後半から有機ELビジネスの立ちあがりを見込み。 |
| システム製品 | 2023年度は、検査等装置とEMSビジネスの増加と、AIサーバー大口案件があり大幅に増加。 2024年度は、反動によりEMSは一服感があるも、検査等装置ビジネスの堅調とAIサーバー等積み重ねで増加見込み。 |
| バッテリー&電力機器 | 2023年度は、主力の家庭用電力貯蔵システム（ESS）ビジネスの減少が主な要因。 2024年度は、ESSビジネスの増加とその他のビジネスの積み重ねにより、増加見込み。 |

※2020年度に品目別の改訂を行っているため、グラフの開始年度は2020年度からになります。

8. 利益増減チャート（経常利益基準）

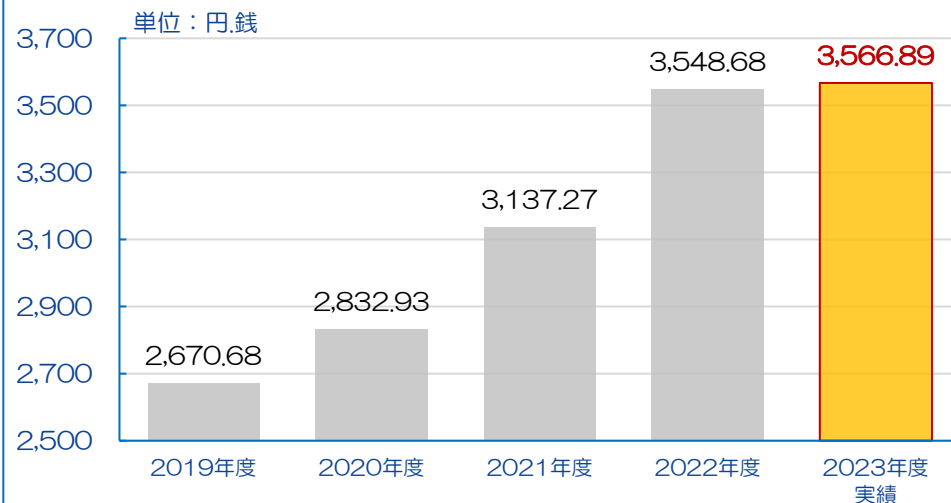


経常利益61.7%減

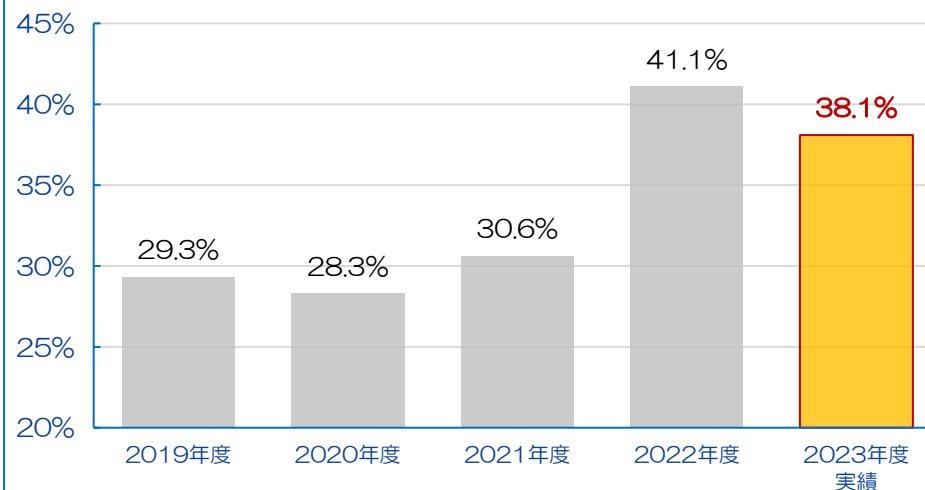
経常利益150.4%増の見込み

9. その他の経営指標推移

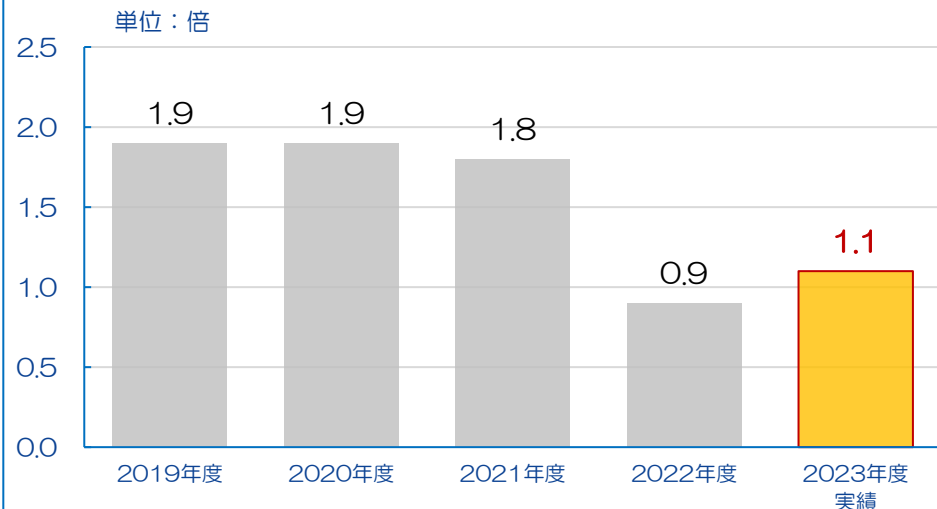
1株あたり純資産



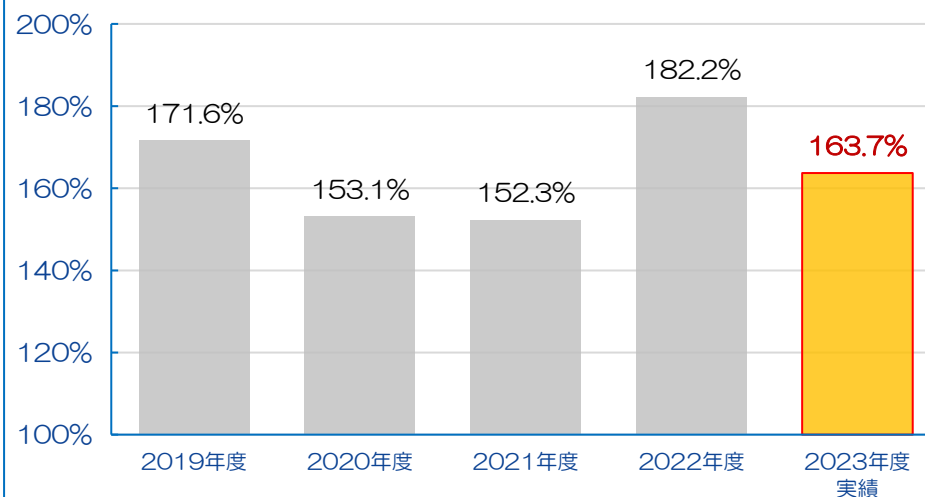
自己資本比率



有利子負債純資産倍率



流動比率



10. 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて

分析指標

▽ 現状評価にあたり、下表は「収益構造改革」を着手する前年度である2019年度を起点としております。

| 指 標 | | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 資本コスト | ① | WACC：（注1） | 2.1% | 2.0% | 3.8% | 7.3% | 5.3% |
| 資本収益性 | ② | ROIC：投下資本利益率（注2） | 2.6% | 3.6% | 6.6% | 13.9% | 6.8% |
| （②－①） | | | +0.5% | +1.6% | +2.8% | +6.6% | +1.5% |
| 資本コストを上回る資本収益性を達成できているか？ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式市場 の評価 | ③ | BPS：1株当たり純資産 | 2,670.68円 | 2,832.93円 | 3,137.27円 | 3,548.68円 | 3,566.89円 |
| | ④ | 株価：年度末時点終値 | 811円 | 2,011円 | 2,030円 | 2,957円 | 3,325円 |
| | PBR：株価純資産倍率（④÷③） | | 0.30倍 | 0.71倍 | 0.65倍 | 0.83倍 | 0.93倍 |
| PBR1倍か？＝十分な市場評価を得られているか？ | | | × | × | × | × | × |

（注1）：WACC（%）＝加重平均負債コスト（%）＋株主資本コスト（%）＝資金調達にどのくらいコストをかけているかを示す指標です。
 なお、2019年度末～2021年度末における株主資本コストの計算に使用した期待収益率及び企業のβ値は暫定値を使用しております。
 （注2）：ROIC＝NOPAT（税引後営業利益）÷投下資本（有利子負債＋株主資本）

現状評価

| | |
|-------------|---|
| 資本収益性に関して | 2020年度開始の前中期経営期間（3か年）において、「収益構造改革」に着手し、2023年度を開始年度とする当中期経営期間（3か年）は、コロナ禍で積み残した課題への対処を行う、総仕上げの期間と位置付けております。当中期経営期間においても、ドル金利や仕入れ価格の上昇の影響を受けつつも、資本効率の向上を追求した各種施策を実施してまいりました。しかしながら、2023年度は資本収益性が悪化しました。これはディスプレイ分野の主要顧客の民事再生にかかる貸倒関連費用を販売費及び一般管理費で計上し、NOPAT（税引後営業利益）が悪化したためです。当該収益性を悪化させた要因は、一時的なものであり、2024年度以降は再び資本収益性が改善するものと評価しております。 |
| 株価の市場評価に関して | 2019年度からの全期間、PBRが1倍割れとなり、株式市場において十分なお評価を得られませんでした。しかしながら、PBRは1倍を割れているものの、「収益構造改革」による業績の改善や、会社説明会の動画配信などのIRを充実させる取組みを通じて、徐々に改善基調にあるものと評価しております。 |

1.1. 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて

方針

3. 「中期経営方針」に記載のとおりとなります。

全社一丸となり、以下の3項目を中期経営方針の基盤とし、デジタル・トランスフォーメーション（DX）、グリーン・トランスフォーメーション（GX）市場の開拓を推進し、サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）への寄与をもって社会への貢献し、企業価値の向上を目指す。

- ① 高利益率化を追求する。
- ② 単品販売志向から脱却し、システムソリューション販売を強化する。
- ③ 経営基盤を強化並びに資金効率の向上をもって財務体質を強化する。

目標

資本収益性

2. 「中期経営目標」に記載のとおりとなります。

- 目標①：連結経常利益 15億円 ▶ 2025年度（2026年3月期）
- ②：ROE 10%以上を継続 ▶ レンジ目標

株価の市場評価

目標：PBR 1倍 ▶ できるだけ速やかに達成

取組・時期

上記目標数値及び達成時期に向け、以下の取組みを2023年度より開始しております。

資本収益性

APPENDIX A1. 「中期経営戦略（販売戦略）」及び、同A2. 「中期経営戦略（経営基盤戦略）③ 資本政策」に記載のとおりとなります。

株価の市場評価

APPENDIX A1. 「中期経営戦略（販売戦略）」及び、同A2. 「中期経営戦略（経営基盤戦略）」

APPENDIX A3. 「サステナビリティへの考え方」（=取組み）を有機的に遂行し、株式市場におけるご評価を頂けるよう努めてまいります。

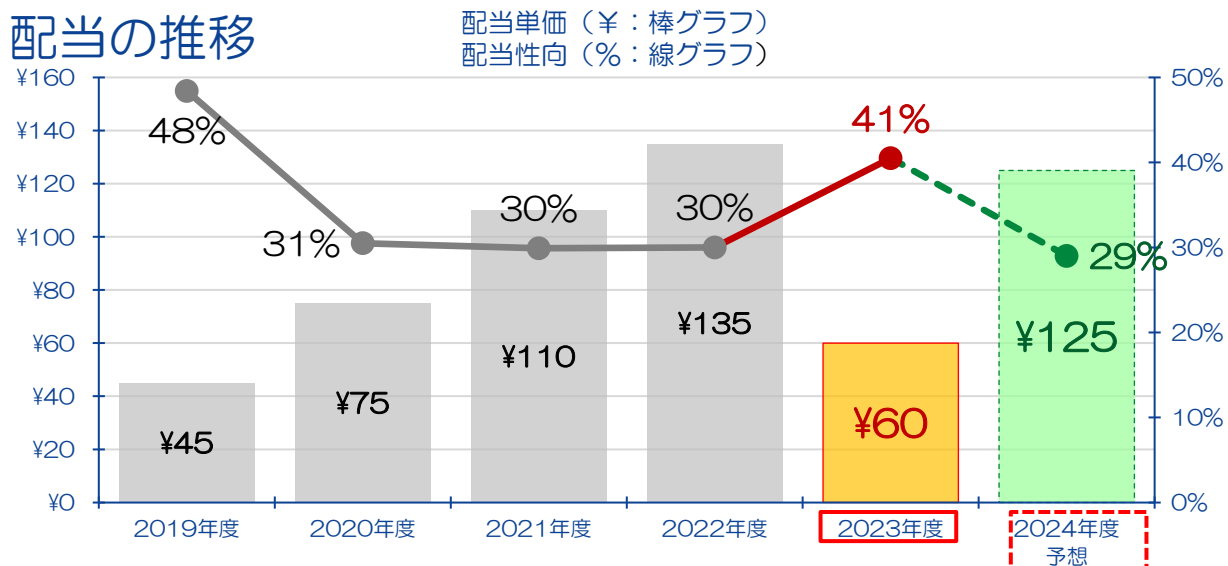
12. 株主還元（配当）

基本方針及び配当政策

当社は、株主様に対する利益還元を重要な経営政策のひとつと位置づけ、財政状態や経営環境等を総合的に勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施いたします。当社の株主様への還元は、年1回 期末配当として、株主総会のご決議により配当を実施することを基本方針としております。

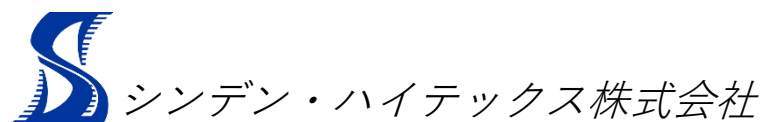


配当の推移



手元流動性資金の確保（＝ビジネスチャンスを逃さない）と、株主還元の充実（配当金等）のバランスをとる。

- 2024年6月の配当は、株主様への還元と、今後の財政状態を総合的に勘案し、2023年8月8日公表の配当単価を維持。
- 2025年6月の配当予想は、通期業績予想を基に配当性向「30%を目安」として設定。



APPENDIX

A1. 中期経営戦略

■ 中期経営戦略（販売戦略）

市場・顧客戦略

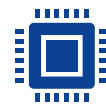
製品戦略

■ 重点市場 ・DX & GX

・5G IoT
・量子コンピュータ
等のDX化の進展に伴う関連機器

脱炭素化社会に向けたエネルギー
マネジメント関連機器

- ① 既存顧客 ▶ 深掘
② 新規顧客 ▶ 開拓



DXの進展を背景としたデジタル化へ対応

SoC、CPU、通信用半導体、メモリモジュール及びSSD等の高付加価値商材の拡販



汎用品及び高付加価値商材のビジネスを両輪で遂行

汎用品は、既存顧客への拡販と商権の拡大を図る。
高付加価値商材は、有機EL等の新規商材や、カスタム対応を強化



「高利益化を追求」「システムソリューション販売」の本丸

EMS及びBoardビジネスの強化
DX関連市場向けのサーバ機器の販売を強化



SX及びGXへの寄与のための重点分野と位置づけ

エネルギーマネジメント及びEV関連商材の発掘と拡販
バッテリーセルとともに、電源等周辺機器やパワーデバイス等もトータルソリューションとして拡販

重点活動

販売戦略の遂行と中期経営目標達成にあたり、「新規開拓活動」を引続き、次期中期経営期間の重点活動とする。

- ・ 既存顧客の深掘 ▶ 半導体製品分野をコア分野とし、ディスプレイ・システム製品・バッテリー&電力機器の各分野の需要をつかみ、相乗効果を発揮させる。
- ・ 新規顧客の開拓 ▶ 産業機器・社会環境関連市場の新規優良顧客の開拓を加速化させる。

■ 中期経営戦略（経営基盤戦略）

① 人的資本に関する戦略

■ 「当社グループの最大の資本は人であり、役員及び従業員が最大限に力を発揮できる環境と共に社業の発展がある」との考えに立脚し、次の人的資本に関する戦略を掲げる。

- SXに寄与する人材の育成 ◀ 適材適所の人員配置を追求 + 実践を通じた育成の場を提供
- 次世代の役員・管理職の育成 ◀ 能力と志を有する従業員に対し、年齢・性別を問わず段階的に実践の場を提供
- 従業員の年齢構成の最適化 ◀ 中途採用を中心とした新規採用によって増員を図る
- より働きがいのある職場づくり ◀ 公正な評価制度を追求
◀ モチベーションアップのための各種制度設計や施策の継続的な検討・推進

② 経営管理機能の強化

- 経営管理機能のDX化を推進 ◀ 「法制度改正への対応」「効率的な働き方の実現」「戦略の実効性把握」

③ 資本戦略

- 在庫運用の適正化を追求 ◀ ビジネス展開を見極める
- 資金調達コストの低減 ◀ 取引金融機関との良好な関係を維持
- 当社株式価値の維持向上 ◀ 会社情報の発信を充実 + 機動的かつ適時適切な資本政策の実施を検討

A3. サステナビリティに関する考え方

当社グループは、「モットー」及び「企業行動憲章」を行動規範とし、「戦略リスク」と「オペレーションリスク」に分類したリスクマネジメントを行いつつ、環境保全に寄与する商品の拡販に注力する取組み、そして、ESGにかかる取組みを通じ、当社グループの持続的成長・発展を図ることが、より良い地球環境や社会への貢献と考え、その実現を目指します。

目標



より良い地球環境や社会への貢献



当社グループの持続的成長・発展



取組

環境保全に寄与する商品の拡販

中期販売戦略（2023年度～）

- 市場・顧客戦略
 - ・重点市場：DX・GX関連市場
 - ・産業機器市場・社会/環境市場の新規優良顧客の開拓
- 製品戦略
 - ・バッテリー&電力機器分野をSXの重点市場に位置づける
 - ・エネルギーマネジメント及びEV関連商材の発掘と拡販

リスクマネジメント

事業のリスクを以下の2種に区分し、リスクマネジメントを行う。

- 戦略リスク

事業戦略の策定及び遂行により健全な範囲で事業成果を獲得するために「敢えて選択して取るリスク」
- オペレーションリスク

戦略遂行を支えるオペレーション上の事象による損失額及び事象発生可能性であり、事業遂行上、「一定以下に抑制すべきリスク」

ESGにかかる取組み

- 環境（Environment）
 - ・ISO14001認証規格の取組
 - ・化学物質管理（禁止化学物質・環境影響物質の管理）
- 社会（Social）
 - ・人権の尊重（当社サプライチェーン内で紛争鉱物調査）
 - ・従業員の適正な処遇、労働環境の整備と育成
- ガバナンス（Governance）
 - ・コーポレートガバナンス・コードへの取組
 - ・コンプライアンス・災害等危機管理への取組

行動規範

モットー

- 当たり前のことを当たり前にする
- やるリスクを負う
- 即断即決
- 常に自分を進化させる
- 人のやらないことをやる
- 一人ひとりが起業家の自覚を持つ
- 過去にとらわれずに新しいことにチャレンジ
- 社員に夢を与える

企業行動憲章

1. 顧客に対する規範
2. 株主に対する規範
3. 従業員に対する規範
4. 営業活動における規範
5. 商品における規範
6. 適正な会計への規範
7. 社内情報・会社財産の尊重
8. 不適切な契約、支出の禁止
9. 広報・広告活動における規範
10. 環境保全にかかる規範
11. 反社会的勢力の排除

A4. 用語解説①

| 用語 | 解説 |
|-------|---|
| 5G | 第5世代移動通信システムのことを指します。現在の第4世代（4G）よりも高速で大容量なデータ通信を提供することができ、高周波数帯（mmWave）と低周波数帯（sub-6GHz）の2つの周波数帯を使用して、高速かつ安定した通信を実現します。これにより、より多くのデバイスが同時に接続できるようになり、IoT（Internet of Things：下段ご参照）や自動運転車などの新しいテクノロジーの発展にも貢献することができます。 |
| ASIC | Application Specific Integrated Circuit：ある特定用途、顧客向けに開発されたカスタムIC（集積回路）です。 |
| ASSP | Application Specific Standard Product：ある特定用途に向けて開発された汎用IC（集積回路）です。 |
| Board | 電子回路基板：ある特定の機能を実現するため、様々な電子部品を実装した回路基板です。 |
| CPU | Central Processing Unit：コンピュータ等の中心的な処理装置としての電子回路。中央処理装置等と訳されます。 |
| EMS | Electronics Manufacturing Service：製品の開発・生産を受託するサービスです。 |
| ESS | Energy Storage System：電力貯蔵システムのことです。 |
| EV | Electric Vehicle：内燃機関でなく電力を動力とする車両のことです。 |
| GPU | Graphics Processing Unit：3Dグラフィックスの表示に必要な計算処理を行う半導体デバイスです。昨今はその高速処理能力を活かし、AI（人工知能）や車載の制御に使用されています。 |
| HBM | High Bandwidth Memory：高帯域幅メモリの略称です。従来のメモリよりも高い帯域幅と効率性を提供することを目的として設計され、データの高速な読み書きを可能にし、高いグラフィックスパフォーマンスや計算能力を実現し、ビッグデータ処理やディープラーニングなどのデータ集中型アプリケーションに特に有益です。また、従来のメモリと比較して非常にコンパクトで、システムの設計上の柔軟性を向上させるとともに、低消費電力です。したがって、主に高性能コンピューター、グラフィックスカード、人工知能（AI）プロセッサ、サーバーなど、高いメモリ帯域幅と効率が必要な分野で利用されています。 |
| IoT | Internet of Things：物のインターネットとも呼ばれます。様々な物や機器がインターネットに接続され、相互に通信し、データをやり取りすることで、自動化や効率化などの利点を生み出す技術のことを指します。様々な分野で応用されており、例えば、自宅の家電製品やセキュリティシステムをスマートフォンから制御したり、自動車や工場の機器を遠隔監視し、自動制御することができます。IoTには、様々なデバイスが必要で、センサーやカメラ、モーターやアクチュエーター、マイクロコントローラーなどが挙げられます。これらのデバイスは、インターネットに接続するための通信モジュールを備え、デバイスがインターネットに接続されることで、データの収集や分析、コントロールなどが可能になります。 |
| LCD | Liquid Crystal Display：液晶ディスプレイのことです。液晶と呼ばれる液体の光学物質を使用して、電気信号を映像に変換する方式で動作します。薄く、軽量で、低消費電力であるという利点があり、携帯電話、パソコン、テレビ、デジタルカメラなど、多くの電子機器に使用されています。 |

A5. 用語解説②

| 用語 | 解説 |
|----------|---|
| SSD | Solid State Drive：半導体メモリをディスクドライブのように扱える補助記憶装置の一種です。 |
| SoC | System on a Chip：半導体製品にあるASICの機種の一つです。 システム全体を1つのチップに集積化することで、高度な機能を実現するための集積回路のことです。SoCには、マイクロプロセッサメモリ、入出カインターフェース、デジタル信号処理回路、アナログ回路、電源回路等、多数の回路が統合されています。 |
| 収益構造改革 | シンデン・ハイテックスが2020年度より本格着手を始めた経営改革を総称したものです。 従来の市場環境の影響を受けやすい汎用品主体のビジネスモデルに加えて、システムソリューション提案、付加価値のある商材の発掘や、各種戦略を有機的に運用するための改革を行い、新たに収益の柱となるビジネスモデルの構築を目指す一連の取り組みです。 |
| パワー半導体 | 高電力電子機器（例えば電力変換器、モータードライブ、電気自動車など）に使用される半導体デバイスの一種です。 高い電力効率、速いスイッチング速度、そして小型化が可能であるという利点を持ちます。これらの特性により、パワー半導体は、現代の高性能電子機器に必須なデバイスとなっています。 |
| ファウンドリ | 顧客から設計データを受け取り、その設計に沿って、半導体メーカーが半導体ウェハを製造することです。 |
| メモリ | 主にパソコンの主記憶装置として使われております。また、多くのデジタル製品に使われるDRAM（Dynamic Random Access Memory）及びフラッシュメモリ等、多様な種類の商品があります。 |
| 量子コンピュータ | 量子力学の原理を利用して情報を処理するコンピュータです。 従来のコンピュータがビット（0と1の二進数）を使用するのに対し、量子コンピュータは、量子ビットを使用します。 量子ビットは、0と1の状態の重ね合わせを持つことができ、これにより、量子コンピュータは多くの計算を並列で実行することができます。また、分子シミュレーションや最適化問題、機械学習など、現代科学技術の多くの分野で重要な役割を果たすことが期待されています。 |
| 有機EL | Organic Electro Luminescence：薄膜の中に有機化合物を挟み込み、電気を流すことで有機化合物が発光する仕組みを利用した発光素子（素子：電気・電子回路を構成する部品の一つで、一定の機能を持った単純な形状の部品）です。 有機ELディスプレイパネルは、従来の液晶ディスプレイパネルに比べて、消費電力が少なく、色再現性が高く、視野角が広く薄型化が可能です。また、柔軟性があり、曲面ディスプレイの実現が可能となります。 |

本資料は、シンデン・ハイテックス株式会社（以下、当社）の事業及び業界動向に加えて、当社による現在の予定、推定、見込みまたは予想に基づいた将来の展望や目標についても言及しています。

これらの将来の展望に関する表明は、様々なリスクや不確実性がつきまっています。

すでに知られたもしくは知られていないリスク、不確実性、その他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。

本資料における将来の展望に関する表明は、**2024年5月10日現在**において、利用可能な情報に基づいて、当社によりなされたものであり、将来の展望に対する表明、予想、目標に関しては、必ずしも実現することをお約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なることもあり得ますことをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ

シンデン・ハイテックス株式会社
経営企画室

フリーコール：0800-5000-345